

# 2018-2024年中国集成电路 行业发展趋势预测及投资战略研究报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

# 一、报告报价

《2018-2024年中国集成电路行业发展趋势预测及投资战略研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/668477ECA7.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

“十三五”期间，我国集成电路产业要充分发挥我国作为全球规模最大、增长最快的市场优势，以应用为牵头，强化产业链协同创新，破除知识产权封锁，以系统厂商为龙头，加强集成电路设计、制造、封装测试、装备和材料为整机服务的协同作用，规避国际巨头的“专利围剿”；统筹产业链的协同发展，走弯道超车的发展之路。

首先，加大整合力度，集中创新资源，提升企业竞争力。根据我国集成电路产业发展现状，积极实施企业兼并重组，可以解决我国集成电路产业结构不合理、集中度低、企业小而分散、同质化竞争的问题。通过兼并重组将资源聚焦于重点优势企业，从而打造具有国际竞争力的集成电路航母企业，可以带动整个产业做大做强。

其次，产业链联动，加快设计、制造、封测垂直整合的步伐。我国集成电路产业要形成以应用为牵引即系统带动整机，整机带动器件的产业链协同发展格局。国产芯片、设计企业与终端厂商联动可大幅缩减研发成本和周期，并带动其产业链条技术创新能力显著增强。

最后，构建产学研用协同创新平台，助推科技成果转化。加快构建“共同投入、联合开发、相互信任、优势互补、利益共享、风险共担”的长效合作机制，推动建立产业联盟、行业技术研究院等产学研合作模式，整合产业技术创新资源，开展协同创新，突破制约我国产业发展的关键重大技术，从源头上解决产业发展的瓶颈。

### 报告目录

第1章：中国集成电路行业发展分析
1.1 集成电路行业发展综述
1.1.1 集成电路行业统计标准
1.1.2 集成电路行业周期性
1.1.3 集成电路行业产业链简介
1.1.4 集成电路行业材料供给分析
（1）国际硅材料供应现状
（2）国内集成电路生产材料供应现状
1.1.5 集成电路生产设备供给分析
（1）国内电子工业专用设备制造业运行情况
（2）国内集成电路装备制造业状况分析
1.1.6 集成电路行业发展环境分析
（1）集成电路行业政策环境分析
（2）集成电路行业经济环境分析
（3）集成电路行业技术环境分析
（4）集成电路行业进出口环境分析
1.2 集成电路行业发展现状分析
1.2.1 全球集成电路行业发展现状
（1）行业需求稳健成长
（2）全球半导体资本开支开始下降，订单出货比稳定
1.2.2 中国集成电路行业发展现状分析
（1）行业经济指标分析
（2）行业结构分析
（3）行业总体技术水平分析
（4）行业总体竞争力分析
1.2.3 集成电路行业区域发展格局分析
（1）国内集成电路行业区域发展现状
（2）国内集成电路行业整体分布格局
1.2.4 集成电路产业面临的发展机遇
1.2.5 集成电路行业面临的主要问题
（1）对进口产品仍有较大依赖性
（2）技术能力不强
（3）在产业格局中处于边缘
1.3 集成电路设计业发展分

析1.3.1 集成电路设计业发展概况分析1.3.2 集成电路设计业市场规模分析1.3.3 集成电路设计业市场特征分析（1）技术能力大幅提升（2）行业发展仍存隐忧1.3.4 集成电路设计业竞争格局分析1.3.5 集成电路设计业发展策略分析1.3.6 集成电路设计业发展前景预测1.4 集成电路制造行业发展分析1.4.1 集成电路制造行业发展现状分析（1）集成电路制造行业发展总体概况（2）集成电路制造行业发展主要特点（3）集成电路制造行业规模及财务指标分析1.4.2 集成电路制造行业经济指标分析（1）集成电路制造行业经济指标分析（2）集成电路制造行业主要经济效益影响因素1.4.3 集成电路制造行业供需平衡分析（1）集成电路制造行业供给情况分析（2）集成电路制造行业需求情况分析（3）全国集成电路制造行业产销率分析1.4.4 集成电路制造行业发展前景预测1.5 集成电路封装测试业发展分析1.5.1 集成电路封测业市场规模分析1.5.2 集成电路封测业经营情况分析1.5.3 国内外厂商技术水平对比分析1.5.4 集成电路封测业竞争格局分析（1）国内集成电路封测业竞争格局分析（2）国内集成电路封测企业国际竞争力分析（3）集成电路封装测试业竞争结构波特五力模型分析1.5.5 集成电路封测业发展趋势分析（1）封装技术发展趋势（2）应用领域发展趋势1.5.6 集成电路封测业发展前景预测

第2章：中国集成电路细分产品市场需求分析2.1 IC卡市场需求分析2.1.1 IC卡市场需求现状分析2.1.2 IC卡市场需求规模分析2.1.3 IC卡市场竞争格局分析（1）市场占有率分析（2）各企业竞争优势分析2.1.4 IC卡市场需求前景预测2.2 计算机市场需求分析2.2.1 计算机市场需求现状分析2.2.2 计算机市场供给规模分析2.2.3 计算机市场需求规模分析2.2.4 计算机市场经营效益分析2.2.5 计算机市场竞争格局分析（1）整体竞争格局分析（2）重点企业竞争格局分析2.2.6 计算机市场发展趋势预测（1）PC市场结构调整，用户数量将下降（2）智能化趋势提供新的机遇（3）游戏本发展迅猛（4）国产化替代浪潮加速2.3 无线通信设备市场需求分析2.3.1 无线通信设备市场需求现状分析2.3.2 无线通信设备市场供给规模分析2.3.3 无线通信设备市场需求规模分析2.3.4 无线通信设备市场竞争格局分析2.3.5 无线通信设备市场需求前景预测（1）全球市场预测（2）国内市场预测2.4 其他消费类电子产品市场需求分析2.4.1 其他消费类电子产品需求现状分析2.4.2 其他消费类电子产品需求规模分析2.4.3 其他消费类电子产品竞争格局分析（1）数码相机竞争格局分析（2）平板电视竞争格局分析（3）智能穿戴设备竞争格局分析2.5 微控制单元（MCU）市场需求分析2.5.1 MCU市场需求现状分析2.5.2 MCU市场需求规模分析2.5.3 MCU市场竞争格局分析（1）MCU市场整体竞争格局（2）MCU细分市场竞争格局2.5.4 MCU市场需求前景预测

第3章：中国集成电路芯片市场需求分析3.1 SIM芯片市场需求分析3.1.1 SIM芯片发展现状分析3.1.2 SIM芯片需求规模分析（1）SIM芯片整体出货量（2）NFC类SIM卡出货量（3）LTE类SIM卡出货量3.1.3 SIM芯片竞争格局分析3.1.4 SIM芯片需求前景预测3.2 移动支付芯片市场需求分析3.2.1 移动支付芯片发展现状分析（1）移动支付产品分析（2）银联与中移动移动支付

标准之争已经解决(3)已有大量POS机支持NFC功能(4)国内供应商开始发力NFC芯片3.2.2 移动支付芯片需求规模分析3.2.3 移动支付芯片竞争格局分析3.2.4 移动支付芯片需求前景预测3.3 身份识别类芯片市场需求分析3.3.1 身份识别类芯片发展现状分析(1)身份识别介绍(2)身份识别分类3.3.2 身份识别类芯片需求规模分析3.3.3 身份识别类芯片竞争格局分析3.3.4 身份识别类芯片存在问题(1)缺乏自主知识产权(2)安全性尚待加强(3)应用尚待开发(4)解决方案仍在探索(5)上游产能不足3.3.5 身份识别类芯片需求前景预测3.4 金融支付类芯片市场需求分析3.4.1 金融支付类芯片发展现状分析3.4.2 金融支付类芯片需求规模分析3.4.3 金融支付类芯片竞争格局分析3.4.4 金融支付类芯片需求前景预测3.5 USB-KEY芯片市场需求分析3.5.1 USB-KEY芯片发展现状分析3.5.2 USB-KEY芯片需求规模分析3.5.3 USB-KEY芯片竞争格局分析3.5.4 USB-KEY芯片需求前景预测3.6 通讯射频芯片市场需求分析3.6.1 通讯射频芯片发展现状分析3.6.2 通讯射频芯片需求规模分析3.6.3 通讯射频芯片竞争格局分析3.6.4 通讯射频芯片需求前景预测3.7 通讯基带芯片市场需求分析3.7.1 通讯基带发展现状分析3.7.2 通讯基带芯片需求规模分析3.7.3 通讯基带芯片竞争格局分析(1)国际厂商竞争格局分析(2)国内厂商竞争格局分析3.7.4 通讯基带芯片需求前景预测(1)基带和应用处理器融合加深(2)价格战将加剧(3)工艺决定竞争力3.8 家电控制芯片市场需求分析3.8.1 家电控制芯片发展现状分析3.8.2 家电控制芯片需求规模分析3.8.3 家电控制芯片竞争格局分析3.8.4 家电控制芯片需求前景预测3.9 节能应用类芯片市场需求分析3.9.1 节能应用类芯片发展现状分析3.9.2 节能应用类芯片需求规模分析3.9.3 节能应用类芯片竞争格局分析3.9.4 节能应用类芯片需求前景预测3.10 电脑数码类芯片市场需求分析3.10.1 电脑数码类芯片发展现状分析3.10.2 电脑数码类芯片需求规模分析3.10.3 电脑数码类芯片竞争格局分析3.10.4 电脑数码类芯片需求前景预测

第4章：中国集成电路下游市场需求分析4.1 计算机行业对集成电路需求分析4.1.1 计算机行业发展现状分析(1)计算机行业产值规模(2)计算机行业外贸出口(3)计算机行业投资情况分析4.1.2 计算机对集成电路需求分析4.2 智能手机行业对集成电路需求分析4.2.1 智能手机行业发展现状分析4.2.2 智能手机对集成电路需求现状4.3 可穿戴设备行业对集成电路需求分析4.3.1 可穿戴设备行业发展现状分析4.3.2 可穿戴设备行业对集成电路需求分析4.4 工业控制行业对集成电路需求分析4.4.1 工业控制行业发展现状分析(1)工业机器人发展现状(2)变频器发展现状(3)传感器发展现状(4)工控机发展现状(5)机器视觉发展现状(6)3D打印发展现状(7)运动控制器发展现状4.4.2 工业控制对集成电路需求现状4.5 汽车电子行业对集成电路需求分析4.5.1 汽车电子行业发展现状分析4.5.2 汽车电子对集成电路需求现状4.5.3 汽车电子对集成电路需求前景

第5章：主要集成电路行业竞争主体发展分析5.1 外商独资企业发展分析5.1.1 外商独资企业发展现状分析5.1.2 外商独资企业市场份额分析5.1.3 外商独资企业经营情况分析5.1.4 外商独资企

业投资并购分析5.1.5 外商独资企业发展战略分析5.1.6 外商独资企业竞争优势分析5.1.7 对外商独资企业发展建议5.2 中外合资企业发展分析5.2.1 中外合资企业发展现状分析5.2.2 中外合资企业市场份额分析5.2.3 中外合资企业经营情况分析5.2.4 中外合资企业投资并购分析5.2.5 中外合资企业发展战略分析5.2.6 中外合资企业竞争优势分析5.2.7 中外合资企业存在问题分析5.2.8 中外合资企业最新动向分析5.2.9 对中外合资企业发展建议5.3 内资企业发展分析5.3.1 内资企业发展现状分析5.3.2 内资企业市场份额分析5.3.3 内资企业经营情况分析5.3.4 内资企业扶持政策分析5.3.5 内资企业投资并购分析5.3.6 内资企业发展战略分析5.3.7 内资企业竞争优势分析5.3.8 内资企业存在问题分析5.3.9 内资企业最新动向分析5.3.10 国内市场进口替代空间分析5.3.11 对内资企业发展建议

第6章：重点区域集成电路产业发展分析6.1 长三角地区集成电路产业发展分析6.1.1 集成电路产业发展概况6.1.2 集成电路产业政策规划分析6.1.3 集成电路设计业发展分析6.1.4 集成电路制造业发展分析6.1.5 集成电路封装测试业发展分析6.1.6 集成电路产业发展前景预测6.2 京津环渤海地区集成电路产业发展分析6.2.1 集成电路产业发展概况6.2.2 集成电路产业政策规划分析6.2.3 集成电路设计业发展分析6.2.4 集成电路制造业发展分析6.2.5 集成电路封装测试业发展分析6.2.6 集成电路产业发展前景预测6.3 泛珠三角地区集成电路产业发展分析6.3.1 集成电路产业发展概况6.3.2 集成电路产业政策规划分析6.3.3 集成电路产业配套发展分析6.3.4 集成电路设计业发展分析6.3.5 集成电路制造业发展分析6.3.6 集成电路封装测试业发展分析6.3.7 集成电路产业发展前景预测6.4 其他重点地区集成电路产业发展分析6.4.1 重庆市集成电路产业发展分析6.4.2 四川省集成电路产业发展分析6.4.3 西安市集成电路产业发展分析6.4.4 湖北省集成电路产业发展分析

第7章：集成电路领先企业发展分析7.1 集成电路综合型企业发展分析7.1.1 武汉光迅科技股份有限公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业组织架构分析（4）企业产品结构分析（5）企业目标市场分析（6）企业营销网络分析（7）企业新产品动向分析（8）企业技术水平分析（9）企业核心竞争力分析（10）企业发展优劣势分析（11）企业最新发展动向7.1.2 大唐电信科技股份有限公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业组织与结构分析（5）企业营销网络分析（6）企业技术水平分析（7）企业核心竞争力分析（8）企业发展优劣势分析（9）企业最新发展动向7.1.3 杭州士兰微电子股份有限公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业目标市场分析（5）企业营销网络分析（6）企业新产品动向分析（7）企业技术水平分析（8）企业核心竞争力分析（9）企业发展优劣势分析（10）企业最新发展动向7.1.4 国民技术股份有限公司发展分析（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业产品结构分析（4）企业目标市场分析（5）企业营销网络分析

(6) 企业新产品动向分析 (7) 企业技术水平分析 (8) 企业发展优劣势分析 (9) 企业最新发展动向

7.1.5 紫光国芯股份有限公司发展分析 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业产品结构分析 (4) 企业目标市场分析 (5) 企业营销网络分析 (6) 企业新产品动向分析 (7) 企业技术水平分析 (8) 企业核心竞争力分析 (9) 企业发展优劣势分析 (10) 企业最新发展动向

7.2 集成电路设计企业发展分析

7.2.1 紫光股份有限公司发展分析 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业产品结构分析 (4) 企业目标市场分析 (5) 企业新产品动向分析 (6) 企业技术水平分析 (7) 企业核心竞争力分析 (8) 企业发展优劣势分析 (9) 企业最新发展动向

7.2.2 深圳海思半导体有限公司 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业产品结构分析 (4) 企业营销网络分析 (5) 企业新产品动向 (6) 企业技术水平分析 (7) 企业核心竞争力分析 (8) 企业发展优劣势分析

7.2.3 中颖电子股份有限公司发展分析 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业产品结构分析 (4) 企业目标市场分析 (5) 企业营销网络分析 (6) 企业新产品动向分析 (7) 企业技术水平分析 (8) 企业核心竞争力分析 (9) 企业发展优劣势分析 (10) 企业最新发展动向

7.3 集成电路制造企业发展分析

7.3.1 中芯国际集成电路制造有限公司发展分析 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业产品结构分析 (4) 企业技术水平分析 (5) 企业新产品动向 (6) 企业营销网络分析 (7) 企业发展优劣势分析 (8) 企业最新发展动向

7.3.2 和舰科技(苏州)有限公司发展分析 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业产品结构分析 (4) 企业营销网络分析 (5) 企业核心竞争力分析 (6) 企业发展优劣势分析 (7) 企业最新发展动向

7.3.3 上海先进半导体制造股份有限公司发展分析 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业产品结构分析 (4) 企业营销网络分析 (5) 企业核心竞争力分析 (6) 企业发展优劣势分析 (7) 企业最新发展动向

7.4 集成电路封装测试企业发展分析

7.4.1 日月光封装测试(上海)有限公司 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业产品结构分析 (4) 企业技术水平分析 (5) 企业销售渠道分析 (6) 企业发展优劣势分析

7.4.2 江苏长电科技股份有限公司发展分析 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业产品结构分析 (4) 企业目标市场分析 (5) 企业营销网络分析 (6) 企业新产品动向分析 (7) 企业技术水平分析 (8) 企业核心竞争力分析 (9) 企业发展优劣势分析 (10) 企业最新发展动向

7.4.3 苏州晶方半导体科技股份有限公司发展分析 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业产品结构分析 (4) 企业目标市场分析 (5) 企业营销网络分析 (6) 企业新产品动向分析 (7) 企业技术水平分析 (8) 企业核心竞争力分析 (9) 企业发展优劣势分析 (10) 企业最新发展动向

7.4.4 天水华天科技股份有限公司发展分析 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业产品结构分析 (4) 企业目标市场分析 (5) 企业营销网络分析 (6) 企业新产品动向分析 (7) 企业技术水平分析 (8) 企业核心竞争力分析 (9) 企业

发展优劣势分析 (10) 企业最新发展动向7.4.5 南通富士通微电子股份有限公司发展分析 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业产品结构分析 (4) 企业目标市场分析 (5) 企业营销网络分析 (6) 企业新产品动向分析 (7) 企业技术水平分析 (8) 企业核心竞争力分析 (9) 企业发展优劣势分析 (10) 企业最新发展动向

第8章：集成电路行业投资战略规划与建议8.1 集成电路行业市场前景预测8.1.1 集成电路行业市场规模预测8.1.2 集成电路行业发展趋势分析 (1) 集成电路行业区域发展趋势 (2) 集成电路行业技术发展趋势 (3) 集成电路行业产品结构趋势 (4) 集成电路行业市场竞争趋势8.2 集成电路行业投资前景分析8.2.1 集成电路行业发展的影响因素分析 (1) 有利因素 (2) 不利因素8.2.2 集成电路行业进入壁垒分析 (1) 技术壁垒 (2) 人才壁垒 (3) 资金实力壁垒 (4) 产业化壁垒 (5) 客户维护壁垒8.2.3 集成电路行业投资风险分析 (1) 政策风险 (2) 宏观经济风险 (3) 供求风险 (4) 其他风险8.2.4 集成电路行业投资前景分析 (1) 行业发展空间较大 (2) 行业政策扶持利好 (3) 下游应用市场增长迅速 (4) 行业目前投资规模偏小8.3 集成电路行业投资机会与建议8.3.1 关于集成电路行业投资热点分析 (1) 集成电路设计业被看好 (2) 网络通信领域依然是核心 (3) 智能家居等市场集成电路需求强劲 (4) 小型化和立体化封装技术具有发展潜力8.3.2 关于集成电路行业投资机会分析8.3.3 关于集成电路细分市场投资建议8.3.4 关于集成电路区域布局投资建议8.3.5 关于集成电路企业并购重组建议

图表目录图表1：集成电路行业代码表图表2：摩尔定律和计算机芯片发展示意图 (单位：个) 图表3：集成电路产业链示意图图表4：不同尺寸单晶硅片的生命周期示意图 (单位：百万平方英寸，年) 图表5：大陆现有12寸晶圆厂产能统计 (单位：千片/月) 图表6：2012-2016年国内电子工业专用设备制造业规模情况 (单位：家，亿元) 图表7：截止2015年10月我国国产设备大生产线验证情况图表8：2016年我国集成电路设备排名前五的企业及主要产品图表9：集成电路行业主要政策分析图表10：2012-2017年中国国内生产总值情况及增长率 (单位：亿元，%) 图表11：2012-2016年我国全部工业增加值增速 (单位：亿元，%) 图表12：2017年上半年及全年中国主要宏观经济指标预测表 (单位：亿元，%) 图表13：国内集成电路制造业销售额与GDP关联分析图 (单位：亿元，万亿元) 图表14：2011-2016年国内集成电路行业发明专利申请数量变化图 (单位：项，%) 图表15：2011-2016年集成电路行业专利公开数量变化图 (单位：项，%) 图表16：1985-2017年10月中国国内十家主要集成电路制造企业专利累计公开数 (单位：项，%) 图表17：截至2017年10月国内集成电路行业发明专利分布领域 (前十位) (单位：项) 图表18：2011-2016年全球集成电路行业规模及增长情况 (单位：亿美元，%) 图表19：2016年全球前十大集成电路设计厂商销售收入 (单位：百万美元，%) 图表20：2012-2016年中国集成电路产业发展情况 (单位：亿元，亿块) 图表21：2011-2016年国内集成电路产业结构 (单位：亿元，%) 图表22：中国集成电路产业长三角地区分布概况图

表23：未来集成电路产业的整体空间布局特点分析  
表24：2016年国内集成电路设计企业主要产品领域分布（单位：家，亿元，%）  
表25：2010-2016年国内集成电路设计市场销售收入和增长情况（单位：亿元，%）  
表26：2016年国内销售前十大集成电路设计企业分析（单位：亿元）  
表27：集成电路设计业发展策略简析  
表28：2018-2024年国内集成电路设计业市场规模预测（单位：亿元，%）  
表29：集成电路制造行业发展主要特点分析  
表30：2015-2016年国内集成电路制造行业规模分析（单位：家，万元）

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/668477ECA7.html>